# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-045256

(43) Date of publication of application: 18.02.1994

(51)Int.CI.

H01L 21/205 H01L 21/203 // G05D 7/06

(21)Application number : **04-193846** 

(71)Applicant: RIKAGAKU KENKYUSHO

**RES DEV CORP OF JAPAN** 

(22) Date of filing:

21.07.1992

(72)Inventor: OZASA KAZUNARI

**MEGURO TAKASHI** 

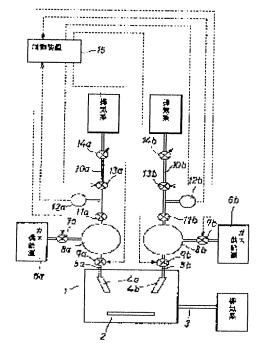
**AOYANAGI KATSUNOBU** 

# (54) METHOD FOR SUPPLYING GAS PULSE AND METHOD FORMING FOR FILM USING THE SAME

# (57)Abstract:

PURPOSE: To provide a method for supplying a gas pulse which can accurately supply even a very small amount of material gas in a pulse state and a method for forming a film to accurately control its thickness at an atomic layer level.

CONSTITUTION: A switching valve 7a is opened in a state that switching valves 9a, 13a are closed, film forming material gas is introduced from a gas supply source 6a into a pressure control tank 8a, and the valve 7a is closed. In this case, a pressure control tank 8a is so controlled by a pressure gage 12a that gas pressure in the tank 8a becomes a predetermined pressure. If it exceeds the predetermined pressure, the valve 13a is opened to exhaust it, and the pressure in the tank 8a is



set to the predetermined pressure. Then, from the state that the valves 7a, 9a, 13a are closed, the valve 9a is opened for a predetermined time. Thereafter, the gas in the tank 8a is supplied from a gas supply nozzle 4a toward a substrate 2 in the chamber 1 in a pulse state.

Searching PAJ Page 2 of 2

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination] 23.07.1997

[Date of sending the examiner's decision of 16.05.2000

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-45256

(43)公開日 平成6年(1994)2月18日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup>		餓別配号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H01L	21/205				
	21/203	M	8422-4M		
// G05D	7/06	Z	9324-3H		

審査請求 未請求 請求項の数 2(全 5 頁)

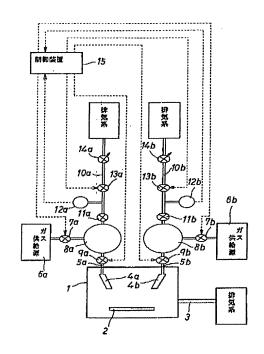
(21)出願番号	特願平4-193846	(71)出願人 000006792
		理化学研究所
(22)出願日	平成 4年(1992) 7月21日	埼玉県和光市広沢 2番 1号
		(71)出願人 390014535
		新技術事業団
		東京都千代田区永田町 2 丁目 5 番 2 号
		(72)発明者 尾笹 一成
		埼玉県和光市広沢 2番 1号 理化学研究所
		内
		(72)発明者 目黒 多加志
		埼玉県和光市広沢 2番 1号 理化学研究所
		内
		(74)代理人 弁理士 須山 佐一
		最終頁に続く

## (54)【発明の名称】 ガスパルスの供給方法およびこれを用いた成膜方法

### (57)【要約】

【目的】 微量の原料ガスであっても精度良くバルス状 に供給することのできるガスバルスの供給方法および原 子層レベルで精度良く 膜厚制御を行うことのできる成膜 方法を提供する。

【構成】 開閉バルブ9a、13aを閉じた状態で、開閉バルブ7aを開け、ガス供給源6aから圧力制御用タンク8aに成膜原料ガスを導入し、開閉バルブ7aを閉じる。この時、圧力計12aによって圧力制御用タンク8a内のガス圧が所定圧になるよう制御する。所定圧を越えてしまった場合は、開閉バルブ13aを開けて排気を行い、圧力制御用タンク8a内のガス圧を所定圧に設定する。この後、開閉バルブ7a、9a、13aを閉じた状態から、所定時間開閉バルブ9aを開ける。すると、圧力制御用タンク8a内の成膜原料ガスが、ガス供給ノズル4aからパルス状に真空チャンバ1内の基板2に向けて供給される。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ガス供給源からの原料ガスをパルス状に して所定量ずつ所定部に供給するガスパルスの供給方法 において.

前記ガス供給源からの前記原料ガスを圧力制御部に収容 し、との圧力制御部と前記所定部とを連通する配管に設 けたバルブを開閉して該圧力制御部内の圧力降下分に相 当する電の前記原料ガスを、前記所定部に供給すること を特徴とするガスパルスの供給方法。

【 請求項2 】 真空チャンパ内に設けた被成膜体に、ガ 10 ス供給源からの成膜原料ガスをパルス状にして所定量ず つ供給し、前記被成膜体に薄膜を形成する成膜方法にお

前記ガス供給源からの前記成膜原料ガスを圧力制御部に 収容し、この圧力制御部と前記真空チャンバとを連通す る配管に設けたバルブを開閉して該圧力制御部内の圧力 降下分に相当する量の前記成膜原料ガスを、前記真空チ ャンパ内に供給し、前記被成膜体に薄膜を形成すること を特徴とする成膜方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、真空チャンパ内等に原 料ガスをパルス状にして所定量ずつ供給するガスパルス の供給方法およびこれを用いた成膜方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来から、原料ガスをパルス状にして所 定置ずつ供給する方法として、ガス供給源から原料ガス を供給する配管にマスフローコントローラもしくは流量 調節バルブを介挿するとともに、このマスフローコント ローラ等の下流側を供給配管とベント配管に分岐し、と の分岐部分に流路切り替え可能なようにパルブを介挿し て、常にベント配管側に一定流量で原料ガスを流して捨 てておき (ベント)、必要な時間だけ流路を切り替えて 供給配管に流す(ラン)方法、いわゆるベントアンドラ ンの方法が知られている。

【0003】また、最近では、基板等に微量な原料ガス をパルス状に供給して、原子層レベルで膜厚を制御をし つつ、結晶成長によって成膜を行う試みがなされてい

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し た従来の方法では、原料ガス配管系のある部位(マスフ ローコントローラのある部位)の原料ガス流量が一定に なるだけで、他の配管部分(前記部位以遠の部分)に存 在する原料ガスの影響あるいはベントとランの切り替え による配管内の圧力変動等によって、実際に真空チャン バ等に供給される原料ガスの量に誤差が生じるという問 **顕がある。また、蒸気圧が低い原料ガスを使用する場合** や、非常に微量の原料ガスを供給する場合等において

いう問題もある。とのため、特に、微量の原料ガスを精 度良くパルス状に供給し、原子層制御を行う結晶成長に よる成膜を行う場合等においては、所望の成膜を行うと とができないという問題があった。

2

【0005】本発明は、かかる従来の事情に対処してな されたもので、微量の原料ガスであっても精度良くパル ス状に供給することのできるガスパルスの供給方法およ び原子層レベルで精度良く膜厚制御を行うことのできる 成膜方法を提供しようとするものである。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明のガス パルスの供給方法は、ガス供給源からの原料ガスをパル ス状にして所定量ずつ所定部に供給するガスパルスの供 給方法において、前記ガス供給源からの前記原料ガスを 圧力制御部に収容し、この圧力制御部と前配所定部とを 連通する配管に設けたバルブを開閉して該圧力制御部内 の圧力降下分に相当する量の前記原料ガスを、前記所定 部に供給することを特徴とする。

【0007】また本発明の成膜方法は、真空チャンバ内 20 に設けた被成膜体に、ガス供給源からの成膜原料ガスを バルス状にして所定量ずつ供給し、前記被成膜体に薄膜 を形成する成膜方法において、前記ガス供給源からの前 記成膜原料ガスを圧力制御部に収容し、この圧力制御部 と前記真空チャンバとを連通する配管に設けたバルブを 開閉して該圧力制御部内の圧力降下分に相当する量の前 記成膜原料ガスを、前記真空チャンパ内に供給し、前記 被成膜体に薄膜を形成することを特徴とする。

#### [0008]

[作用] 上記構成の本発明のガスパルスの供給方法で は、ガス供給源からの原料ガスを圧力制御部(圧力制御 用タンクまたは配管そのもののタンク相当部分)に収容 し、この圧力制御部と真空チャンバ等とを連通する配管 に設けたバルブを開閉して該圧力制御部内の圧力降下分 に相当する量の原料ガスを供給する。したがって、微量 の原料ガスであっても精度良くバルス状に供給すること

[0009]また、本発明の成膜方法では、上記ガスバ ルスの供給方法を用いて、真空チャンバ内に成膜原料ガ スを供給する。したがって、正確に所定量の成膜原料ガ 40 スを供給することができ、原子層レベルで精度良く膜厚 制御を行うことができる。

#### [0010]

【実施例】以下、本発明の一実施例を図面を参照して説 明する。

【0011】図1は、本発明の一実施例の構成を示すも ので、図において1は成膜を行う真空チャンバであり、 との真空チャンバ1内には、成膜を行う基板2が配置さ れている。また、この真空チャンパ1には、真空排気を 行うための排気配管3が接続されており、基板2の前方 は、マスフローコントローラを用いることができないと 50 には、基板2に向けて所定の成膜原料ガスを供給するた めのガス供給ノズル4a、4bが設けられている。な お、このガス供給ノズル4 a、4 b は必要なガス種の数 に応じて1または複数設けられるが、本実施例では、2 つ設けられている。

【0012】これらのガス供給ノズル4a、4bは、ガ ス供給配管5a、5bを介してガス供給源6a、6bに 接続されている。また、ガス供給配管5a、5bには、 ガス供給源6a、6b側から順に、開閉パルブ7a、7 b、圧力制御用タンク8a、8b、開閉パルブ9a、9 bが設けられている。なお、本実施例においては、圧力 10 制御用タンク8a、8bとして、例えば、容量数十乃至 数百ミリリットル程度の円形容器状のタンク等を用い

【0013】また、上記圧力制御用タンク8a、8bに は、排気系に接続された排気配管10a、10bが接続 されており、この排気配管10a、10bには、圧力制 御用タンク8a、8b側から順に、開閉バルブ11a、 11b、圧力計12a、12b、開閉パルブ13a、1 3 b、流量調節バルブ14a、14bが介挿されてい る。 これらの開閉バルブ7 a、7 b、9 a、9 b、13 a、13bは、それぞれ制御装置15に接続され開閉制 御されるよう構成されており、圧力計12a、12bの 圧力検出信号は、制御装置15に入力されるように構成 されている。

【0014】上記構成の装置を用いて、本実施例では、 制御装置15によって次のように開閉バルブ7a、7 b、9a、9b、13a、13bを制御し、ガス供給ノ ズル4a、4bから基板2に向けて所定の成膜原料ガス を供給し、成膜を行う。なお、以下では、ガス供給ノズ ル4a側についてのみ説明する。また、図2のグラフに この時の圧力制御用タンク8 a 内の圧力の変化およびガ ス供給ノズル4aからのガス流量の変化を示す。

【0015】成膜原料ガス供給に先立って、排気配管3 によって排気を行い、真空チャンバ1内を所定の真空度 (例えば10<sup>-\*</sup>Torr) に設定しておく。

【0016】また、排気配管10aによって圧力制御用 タンク8 a も真空 (例えば10 - Torr) に設定してお く。

【0017】以下の説明中では、開閉バルブ11aは常 に開けておき、圧力制御用タンク8aの圧力は圧力計1 2 a で測れるようにしておく。

【0018】そして、まず、開閉バルブ9a、13aを 閉じた状態で、開閉バルブ7aを開け、ガス供給源6a から圧力制御用タンク8 a に成膜原料ガスを導入し、開 閉バルブ7aを閉じる。との時、圧力計12aによって 圧力制御用タンク8a内のガス圧が所定圧(例えば1~ 0. 01 Torr程度) になるよう制御する。そして、所定 圧を越えてしまった場合は、開閉バルブ13aを開けて 排気を行い、圧力制御用タンク8 a内のガス圧を所定圧 に設定する。

【0019】この後、開閉バルブ7a、9a、13aを 閉じた状態から、所定時間(例えば1~2秒)開閉バル ブ9 a を開ける。すると、圧力制御用タンク8 a 内の成 膜原料ガスが、ガス供給ノズル4 aからパルス状に真空 チャンバ1内の基板2に向けて供給される。この時の供 給量は、圧力制御用タンク8aおよびそれに連結されて いて同じ圧力になる部分の容積と、圧力減少分とによっ て決まるので、正確に制御することができる。

【0020】なお、この時、開閉バルブ9aを所定時間 開けるのではなく、圧力計12aからの圧力検出信号を フィードバック信号として、所定の圧力減少が生じるよ **うに、開閉バルブ9aを開閉制御してもよい。** 

【0021】このような制御による成膜原料ガスの供給 を、ガス供給ノズル4b側についても同様にして行い、 成膜を行う原子層数に応じて、例えば3原子層の膜を形 成する場合は、上述したガスパルスの供給をそれぞれる 回ずつ行って、基板2に成膜を実施する。

【0022】このような方法により、以下に示すように 実際に成膜原料ガスとして、N、OとDMA1Hを用い て、GaAs基板上に酸窒化アルミニウム膜を形成し た。なお、使用した圧力制御用タンク8a、8bの容積 は、連結部を含めて51cm'である。

【0023】縦軸を真空チャンバ1内および圧力制御用 タンク8a内の圧力、横軸を時間とした図3のグラフに 示すように、圧力制御用タンク8aに、N、Oを導入 し、排気を実施するととにより、圧力制御用タンク8 a 内の圧力が4.0×10<sup>-1</sup>Torrとなるように設定した。 なお、本実施例の場合成膜原料ガスの供給ラインが最適 化されていなかったため、一旦倍近い圧力になってしま っている。

【0024】そして、開閉バルブ9aを0.5秒だけ間 開けた。すると、開閉バルブ9aを開けた直後、真空チ ャンバ1内の圧力は、3×10-\*Torrから2×10-\*To rrに急激に上昇し、直ちに減少し始め、開閉バルブ9 a を閉じると、真空チャンバ1内の圧力は、急速に回復し 10<sup>-7</sup>Torr以下になった。との時、開閉バルブ9 aを閉 じた時点での圧力制御用タンク8a内の圧力は2.0× 10<sup>-1</sup>Torrとなっていた。

【0025】とのようなガスパルスの供給を、N、O (ガス供給ノズル4a側)とDMA1H(ガス供給ノズ ル4 b側) について交互に1000回行ったところ、基 板温度300℃に保持した15mm×15mmのGaA s 基板上に、厚さ約300nmの均一な酸窒化アルミニ ウム膜が堆積した。

【0026】ととで、1回あたりの原料導入量は、

 $51 \text{ cm}^3 \times (4.0-2.0) 10^{-1} \text{Torr}$ 

 $= 10.2 \text{ cm}^3 \cdot \text{Torr}$ 

 $= 1.34 \times 10^{-1} \cdot 1 \cdot atm$ 

となり、室温20℃を考慮すると気体の状態方程式よ 50 り、この量は5. 6×10-7mo1に相当している。す なわち、1回あたり5.6×10-7mo1の原料が精度 よく供給されていることがわかった。

【0027】このように、本実施例によれば、微量な成膜原料ガスを、所定量ずつ精度良くパルス状に供給することができ、原子層レベルで精度良く膜厚制御した薄膜を形成することができる。

#### [0028]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のガスバルスの供給方法によれば、微量の原料ガスであっても精度良くパルス状に供給することができる。また、本発明の10成膜方法によれば、原子層レベルで精度良く膜厚制御を行うことができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の構成を示す図。

【図2】図1の実施例を説明するための図。

\*【図3】成膜を行った実施例を説明するための図。 【符号の説明】

6

- 1 真空チャンバ
- 2 基板
- 3 排気配管

4a、4b ガス供給ノズル

5a、5b ガス供給配管

6a、6b ガス供給源

7a, 7b, 9a, 9b, 11a, 11b, 13a, 1

) 3b 開閉パルブ

8a、8b 圧力制御用タンク

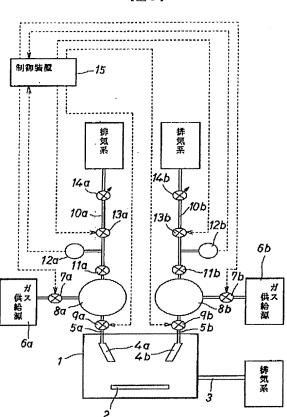
10a、10b 排気配管

12a、12b 圧力計開閉パルブ

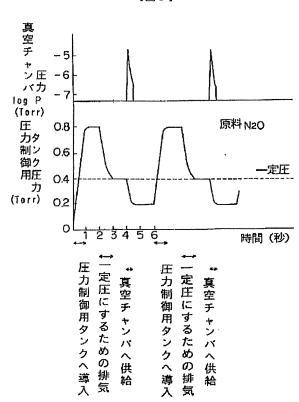
14a、14b 流量調節パルブ

15 制御装置

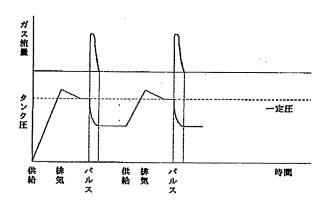
[図1]



[図3]







フロントページの続き

(72)発明者 青柳 克信

埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所

内